

CINDAS网络版

微电子封装材料数据库 (The Microelectronics Packaging Materials Database, MPMD)

MPMD数据库是包含关于微电子封装材料的热、机械、电和物理性能的数据，它收录了1112种材料，424种性能的数据，约24,940条数据曲线。

MPMD数据库由SRC (Semiconductor Research Corporation, 世界领先的研究半导体及相关技术的企业、大学与研究所联盟) 的资助下开发，该研究项目的成果原本只提供给SRC的成员单位，现在为全世界的工程师和科学家们服务，且内容继续不断更新。

通过以下方式检索和浏览MPMD数据库

材料组别

(如胶粘剂, 陶瓷, 无填充环氧树脂, 半导体等)

材料名称

(如银填充环氧树脂, 铁铝金属间化合物, 锗等)

性能组别

(如电、机械、热物理、光等)

性能名称

(如介电常数、泄漏电导, 弹性模量等)

界面工具

保存—数据以便作进一步分析

复制—易于嵌入 PPT 的图表

表达和操作—动态的数据库内容

界面功能

查找—通过浏览, 找到材料组别、性能组别; 通过检索, 找到材料名称、性能名称

查看—特定性能随着温度或者其他自变量的改变所受的影响

比较—同一图表中不同材料的多条数据曲线

参考—显示于相应的文本窗口

理论&测量—提供性能定义和测试信息

检索和浏览MPMD数据库示范

A. 查找信息

检索： 输入性能或者材料的全名或者部分名称

MPMD (version 8, data updated 2010.4) [Start Over](#) | [Help](#)

Browse By:
Material Group
or
Property Group

Search By:
Material Name
e.g., m100, 10101 Inconel

or
Property Name
e.g., elastic, electric conductivity

浏览： 使用下拉菜单查找性能和材料

MPMD (version 8, data updated 2010.4) [Start Over](#) | [Help](#)

Select Property Group: Mechanical Properties - Stress

Select Property Name: (13 property groups)

- Biaxial Stress
- Uniaxial Stress, Yield
- Compressive Lower Yield Stress
- Compressive Stress
- Compressive Stress in Pa
- Compressive Stress, True
- Critical Resolved Shear Stress
- Cure Stress
- Ultimate Flexural Limit
- Film Stress
- Flexural Stress
- Flux Stress
- In Plane Shear Stress
- Residual Stress
- Rupture Stress, Normalized to F(T,U)
- Shear Stress
- Shear Stress in Pa
- Shear Stress, Resolved
- Stress Relaxation
- Tensile Flow Stress
- Longitud Stress
- Tensile Stress in Pa
- Tensile Stress, True
- Longitud Stress, True in Pa
- Tensile Upper Yield Stress
- Thermal Stress
- Transverse Rupture Stress

MPMD数据库包括25种材料组别、1112种材料，13个性能组别、424种性能。

B. 取定信息

选择： 自变量



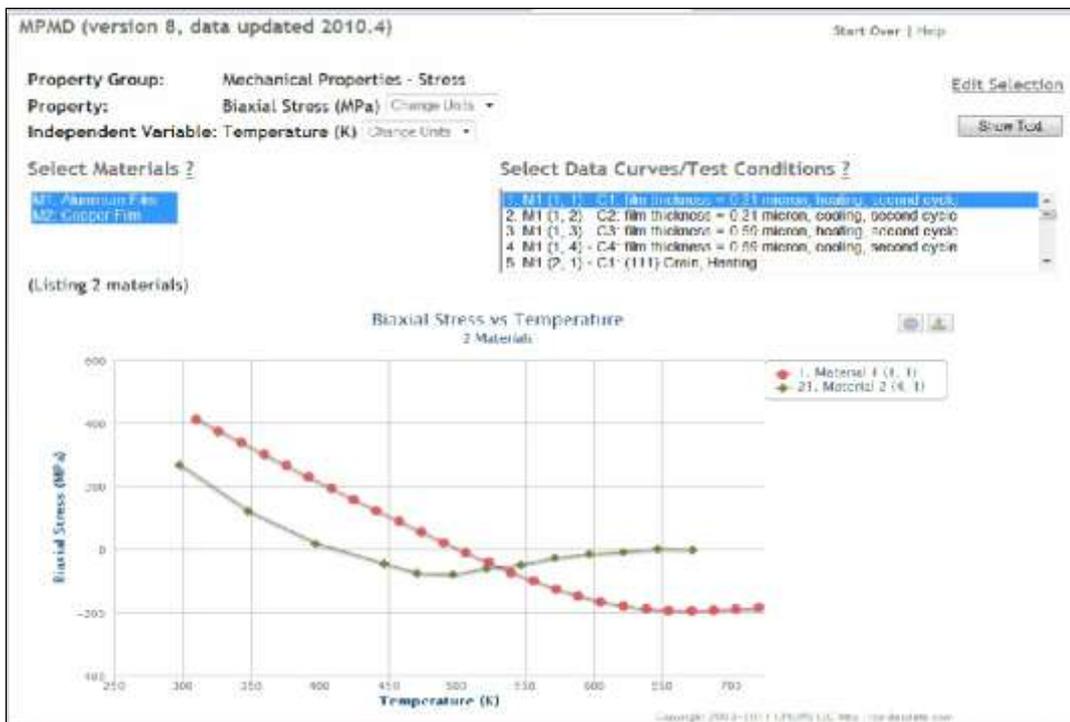
C. 查看信息

用户能够在一张图表上比较多种材料的同一性能。

步骤一： 选择材料

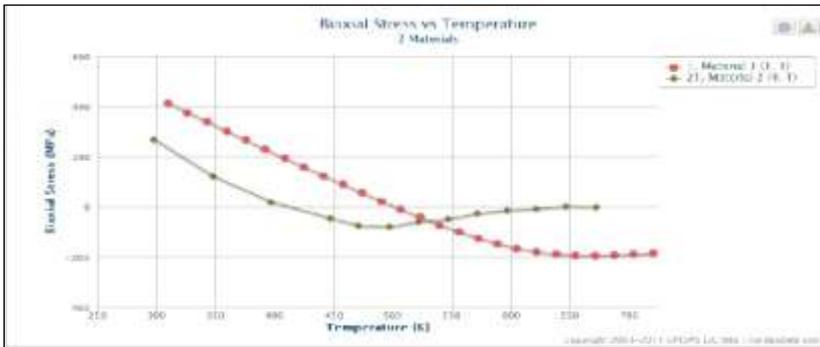
步骤二： 选择测试条件或者数据曲线

注：用户可以随时点击“Show text”按钮，查看数据点的数值，查看文本形式的描述和参考信息



D. 定制信息的显示形式：图表和数字

- 约24,940条数据曲线
- 彩色编码的数据曲线
- 同一图表上显示不同材料的多条数据曲线
- 将光标悬停在每个数据点上，以显示相应的X和Y数值
- 可以改变X轴和Y轴的属性单位（包括所有常用的英制或国际单位制单位）



材料组别

MPMD数据库包括25种材料组别、1112种材料。用户可以通过检索方式或者浏览方式查找所需材料。如果使用全名进行检索，用户可以直接找到所需的材料；如果使用部分名称（关键字）进行检索，相匹配的所有材料都会被显示出来。

胶粘剂 — 30种

陶瓷-高钾氧化物 — 33种

陶瓷-氮化物，硅化物，碳化物等 — 30种

陶瓷-其他 — 22种

陶瓷-氧化物 — 34种

金属陶瓷 — 3种

涂料和未饱和环氧树脂 — 25种

复合材料-层压板 — 126种

复合材料-层压板（玻璃/环氧） — 74种

复合材料-其他 — 51种

复合材料-热处理 — 46种

复合材料-塑模 — 55种

元素 — 33种

密封剂和底部填充材料 — 27种

金属间化合物，铝化物 — 66种

金属间化合物，铍化物 — 35种

金属间化合物，杂类 — 50种

金属间化合物，硅化物 — 30种

液体和气体 — 5种

金属合金 — 58种

聚合物-其他 — 23种

聚合物-聚酰亚胺 — 54种

半导体和光传感材料 — 59种

焊料-无铅 — 57种

焊料-含铅 — 41种

性能组别

MPMD数据库包含424种不同的性能。这些性能被收录在13个易于查找的性能组别中。用户可以通过检索方式或者浏览方式查找所需性能。如果使用全名进行检索，用户可以直接找到所需的性能；如果使用部分名称（关键字）进行检索，相匹配的所有性能都会被显示出来。

热物理性能 — 43种

热辐射性能 — 11种

电性能 — 44种

机械性能：

蠕变 — 9种

疲劳性能 — 9种

硬度 — 9种

模量 — 52种

应变 — 45种

强度 — 44种

应力 — 32种

其他 — 415种

光性能 — 20种

其他性能 — 64种

完整的数据包

最全面的材料研究与应用的资料库，包括如下五个互为补充的数据库：

ASMD—宇航结构金属数据库

HPAD—高性能合金数据库

AHAD—宇航和高性能合金数据库 TPMD—材料热物理性能数据库

MPMD—微电子封装材料数据库

CLTD—超低温和低温数据库

CINDAS数据库提供所涉及材料的成分组成、制作和特定测试，并绘制成图表。

详情请见：<https://cindasdata.com/resources>

访问权

CINDAS数据库的订购价格取决于所选购的数据库品种，每个数据库使用地点的数量，以及每个使用地点的潜在用户数。数据库通过IP控制，订购成功，并且获得有效的IP地址之后，工程师、图书馆员、研究员和科学家们可以无限制的远程访问所订购的数据库。

对于MPMD数据，我们充满信心

MPMD 数据库检索快捷、高效，内容不断更新。越来越多的大学、研究机构正在使用 MPMD 数据库。

联系方式

◆ **Mailing Address**

CINDAS LLC

Purdue Technology Center- Aerospace

1801 Newman Road, Suite 1150

West Lafayette, IN 47906-4524 USA

◆ **Phone/Fax**

+1 765 807-5400 for pricing and other questions: Mr. Frank Mason

+1 765 807-6052 for technical issues: Mr. Stan Setlak

+1 765 807-5291 fax

◆ 本数据库在国内由 iGroup 亚太资讯集团公司代理